



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20121026002B

2013 年 1 月 22 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

QFP/TSSOP パッケージ 一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイヤ変更のご案内

(既報 67 製品からの対象除外 3 製品の連絡)

(初版 PCN20121026002A 2012 年 12 月 7 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての追加連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30 日**以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、初版発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、初版発行日より **90 日**以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)		☒ Final notice	
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☐ Site	☐ Process	☒ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling		☐ -
変更内容	下記変更について既報 67 製品からの対象除外 3 製品の連絡になります。 QFP/TSSOP パッケージ 一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイア変更 現行 : Au(金)線 変更後 : Cu(銅)線			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	—			
品質認定試験	☐ 計画		☒ 終了	
製品表示	☒ 変更無し		☐ 変更あり	
備考	—			

変更内容

内容：今回のお知らせは、下記変更について既報 67 製品からの対象除外 3 製品の連絡になります。弊社 EPD(エンベデッドプロセッシング) QFP/TSSOP パッケージ 一部製品について、現行 Au(金)線ボンディングワイアを使用して製造していますが、機械/電気的特性の向上、同種製品の組立技術推移対応及び供給能力/部材調達利便性向上の為に、Cu(銅)線ボンディングワイアに変更します。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差)、外観、動作特性、品質、信頼性への影響はありません。

変更内容

ボンディングワイア
ワイヤ径

現行

Au(金)線
0.96 mils

変更後

Cu(銅)線
0.80 mils

理由：機械/電気的特性の向上、同種製品の組立技術推移対応及び供給能力/部材調達利便性向上の為

対象製品リスト

対象製品名				
□:既報対象品 取消線:対象除外品				
SF2801PZA	TAS5504APAG	TMS320F28021DAS	TMS320F28065PFPS	TNETV100PZ
SF2808PZA	TAS5504APAGG4	TMS320F280220DAS	TMS320F28066PFPS	TNETV105PAP
SLF2808PZA	TAS5504APAGR	TMS320F280220PTS	TMS320F28067PFPS	TVP5146M1PFP
SM28028PAG	TAS5504APAGRG4	TMS320F280230DAS	TMS320F28068PFPS	TVP5146M1PFPG4
SM28028PAGT	TAS5518PAGR	TMS320F280230PTS	TMS320F28069PFPS	TVP5146M2PFPR
SMDY28031PAGT	TAS5518PAGRG4	TMS320F280260DAS	TMS320F28232PTPS	TVP5147PFP
SNO411146PFP	TMS320C54V90APGE	TMS320F280260PTS	TMS320F28235PTPS	TVP5150APBS
SNO411146PFPG4	TMS320C54V90PGE	TMS320F28026DATR	TMS320F28332PTPS	TVP5150PBS
SNO411146PFPR	TMS320DA105PGE160	TMS320F280270DAS	TMS320F28334PTPS	TVP5151IPBS
SNO411146PFPRG4	TMS320DA105PGE16G4	TMS320F280270PTS	TMS320R2812PGFS	TVP5154PNP
SN606070PAGR	TMS320DA140PGE16D	TMS320F28035PAGTR	TMS320VC5404PGE	TVP5154PNPR
TAS3103DBT	TMS320DSP105APGE16	TMS320F28062PFPS	TMS320VC5410APGE16	
TAS3103DBTG4	TMS320F280200DAS	TMS320F28063PFPS	TMS32DSP5410APGE16	
TAS3308PZT	TMS320F28020PTS	TMS320F28064PFPS	TMSDVC5410APGE16G4	

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2012 年 9 月 26 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TMS320F2803XAPN	-	-	
Assembly Site:	PHI (TIPI)	Package/Code/Pins:	LQFP/PN/80	
Mount Compound:	4042504	Mold Compound:	4205442	
Bond Wire:	0.80 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp. Storage Bake	150C, 1000hrs	77/0	77/0	77/0
**Biased Temp. Humidity	85C/85%RH, 1000 Hrs	80/0	80/0	80/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C.				

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2012 年 9 月 26 日	
信頼性試験 - 試料構成詳細					
Device ID:	Device1	Device2	Device3	Device4	
Qual Device:	TAS3108DCPR	TAS3308PZT	TAS5508BPAG	THS8200PFP	
Assembly Site:	TI Taiwan	TI Taiwan	TI Taiwan	TI Taiwan	
Package/Code/Pins:	TSSOP/DCP/38	TQFP/PZT/100	TQFP/PAG/64	TQFP/PFP/80	
Mount Compound:	4208458	4042504	4042504	4042504	
Mold Compound:	4205443	4205442	4205442	4205443	
Bond Wire:	0.80 Mil Dia., Cu	0.80 Mil Dia., Cu	0.80 Mil Dia., Cu	0.80 Mil Dia., Cu	
Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	NiPdAu, Cu	NiPdAu, Cu	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	JEDEC L-3/260C	JEDEC L-4/260C	JEDEC L-3/260C	
信頼性試験結果					
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails			
		Device1	Device2	Device3	Device4
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	-	Approved	-
Electrical Characterization	-	-	Approved	-	Approved

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2012 年 9 月 26 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TMS320F28015PZA	-	-	
Assembly Site:	TI Philippines	Package/Code/Pins:	TQFP/PFP/80	
Mount Compound:	4042504	Mold Compound:	4205442	
Bond Wire:	0.80 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp. Storage Bake	170C, 420hrs	90/0	90/0	90/0
**T/C	-65C/150C, 1000 Cyc	90/0	90/0	90/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C.				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2012 年 9 月 26 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TMS320F2812PGFA	-	-	
Assembly Site:	TI Philippines	Package/Code/Pins:	TQFP/PGF/176	
Mount Compound:	4042504	Mold Compound:	4205442	
Bond Wire:	0.80 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp. Storage Bake	170C, 420hrs	90/0	90/0	90/0
**T/C	-65C/150C, 1000 Cyc	90/0	90/0	90/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C.				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2012 年 9 月 26 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TVP5147M1PFPR	-	-	
Assembly Site:	TI Taiwan	Package/Code/Pins:	TQFP/PFP/80	
Mount Compound:	4042504	Mold Compound:	4205443	
Bond Wire:	0.80 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp. Storage Bake	170C, 420hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 1000 Cyc	77/0	77/0	77/0
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C.				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2012 年 9 月 26 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device ID:	Device1	Device2	Device3	
Qual Device:	TVP5150AM1PBSR	TVP5154APNPR	TVP7000PZP	
Assembly Site:	TI Taiwan	TI Taiwan	TI Taiwan	
Package/Code/Pins:	TQFP/PBS/32	TQFP/PNP/128	TQFP/PZP/100	
Mount Compound:	4042504	4042504	4042504	
Mold Compound:	4205442	4205443	4205443	
Bond Wire:	0.80 Mil Dia., Cu	0.80 Mil Dia., Cu	0.80 Mil Dia., Cu	
Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	NiPdAu, Cu	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	JEDEC L-3/260C	JEDEC L-3/260C	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Device1	Device2	Device3
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved